

利用課題番号 : F-13-WS-0063
利用形態 : 技術相談
利用課題名 (日本語) : 樹脂複層フィルムの直接接合技術開発
Program Title (English) : Development of direct bonding method for organic multi-layer films
利用者名 (日本語) : 石橋健一¹⁾
Username (English) : k. Ishibashi¹⁾
所属名 (日本語) : 1)株式会社 半一
Affiliation (English) : 1)Hangichi. Co.

1. 概要 (Summary) :

早稲田大学の水野 准教授が有する異種基材の樹脂フィルムに対して低温接合を行うための初期検討を議論した。本課題では、対向する異種フィルム接合面のそれぞれにシランカップリング剤により自己組織的に官能基修飾を行い、官能基修飾を用いた樹脂フィルム接合技術開発の課題検討を行った。その結果、100°C以下の低温でプラズマによる表面処理なしに接合ができる可能性を見出すことができた。

2. 実験 (Experimental) :

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし。

6. 関連特許 (Patent) :

なし。